

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-012

**博通集成电路（上海）股份有限公司**  
**关于向银行申请综合授信额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 申请综合授信情况概述

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过100,000万元人民币或等值人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担保。

本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长在上述范围内代表公司办理相关程序，并签署相关法律文件。

《关于向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2023年4月27日